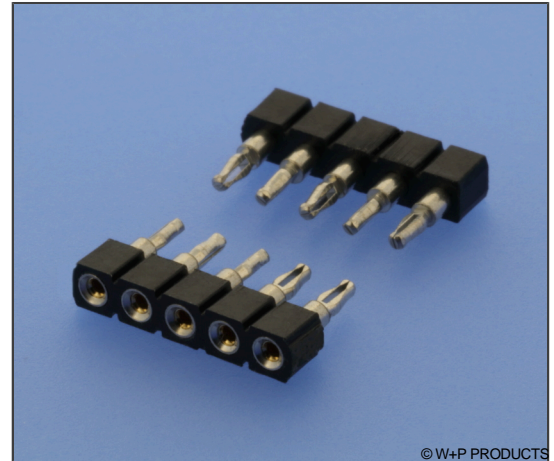


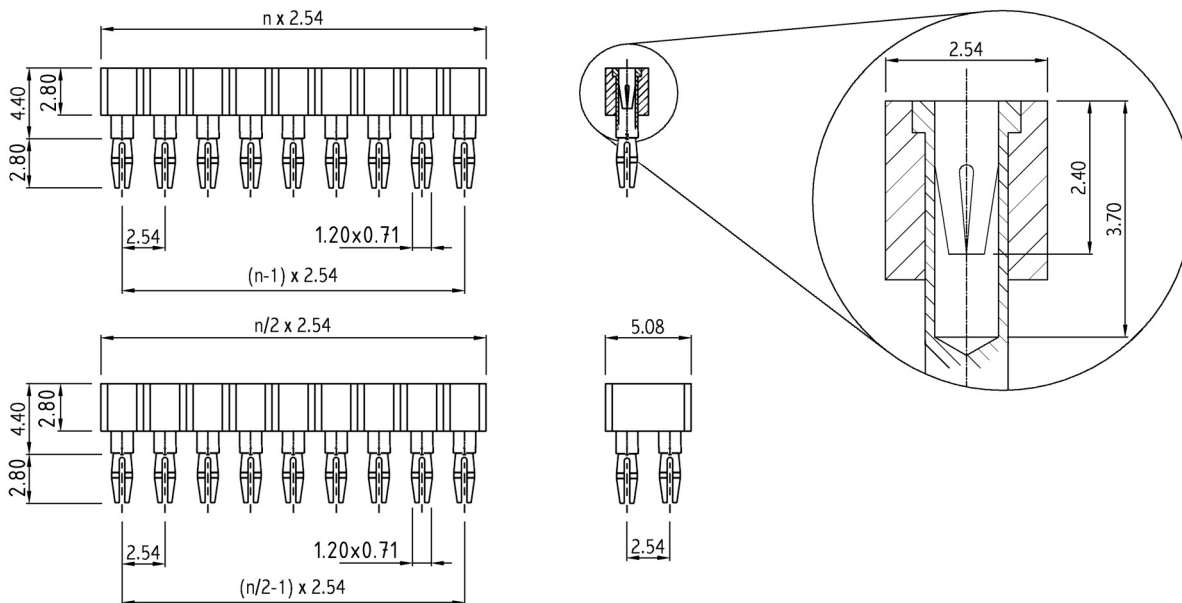
### Technische Daten / Technical Data

Gehäuse/Abdeckung/Hebel	Thermoplast, nach UL94 V-0
Case/Cover/Actuator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 4-Lamellen-Clip, Kupferlegierung
Contact Material	Sleeve: screw machined brass Clip: 4-Finger-Clip, copper alloy
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni
Contact Surface	Acc. to options (see below), over Ni
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	< 10 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Test Voltage	1 kV RMS
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC
Voltage Rating	100 V RMS / 150 V DC
Nennstrom	1 A
Current Rating	1 A
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	-55 °C ... +125 °C



© W+P PRODUCTS

Für Rundstifte Ø0,40-0,56mm  
oder Vierkantstifte 0,25x0,45mm.  
For Ø0.40-0.56mm round pins  
or 0.25x0.45mm rectangular pins.



#### Series

**182PF**

182PF IC-Leiste  
IC-Strip

#### Contacts\*

**16**

01-20 Einreihig  
Single row  
02-64 Zweireihig  
Double row

#### Rows\*

**2**

1 Einreihig  
Single row  
2 Zweireihig  
Double row

#### Sleeve Plating

**50**

50 Verzinkt (Standard)  
Tin plated (Standard)

#### Clip Plating

**00**

00 Vergoldet  
Gold plated

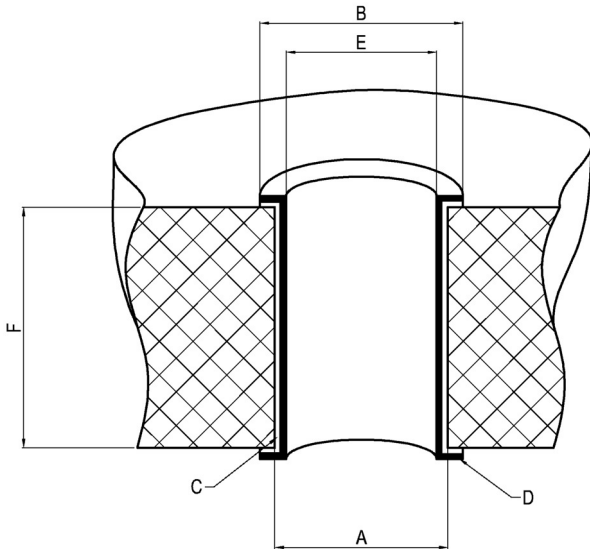
\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

# PressFit Lochdefinitionen

## PressFit Hole Definitions

### Empfohlene Maße der Einpresszonen unserer PressFit Stift- und Buchsenleisten

Recommended Dimensions of PressFit Through Holes



A	Bohrungs-Ø	Base Hole Ø
B	Ring-Ø	Ring Ø
C	Cu-Schicht	Cu Layer
D	Veredelung	Plating
E	Endloch-Ø	Final Hole Ø
F	Leiterplattendicke	PCB Thickness

Serie Series	RM / Pitch [mm]	A [mm]	B [mm]	C [µm]	D Option [µm]		E [mm]	F [mm]	Max. PCB-Kräfte Max. PCB Forces
					Sn	Au/Ni			
943PF, 944PF 943PFS, 944PFS	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05-0,2 Au 2,5-5 Ni	1,00 <sup>+0,09</sup> <sub>-0,06</sub>	min. 1,60	in: 150 N per pin
314PF	2,00	0,89±0,03	min. 1,30	min. 30	max. 1,5 Sn	0,05-0,2 Au 2,5-5 Ni	0,81±0,05	min. 1,60	in: 100 N per pin
153PF	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	5-15 Sn	0,05-0,2 Au 2,5-5 Ni	1,00 <sup>+0,09</sup> <sub>-0,06</sub>	min. 1,60	in: 89 N per pin
182PF	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05-0,2 Au 2,5-5 Ni	1,00 <sup>+0,09</sup> <sub>-0,06</sub>	min. 1,60	in: 89 N per pin
138PF	2,54	1,15±0,03	min. 1,35	min. 25	max. 1,5 Sn	0,05-0,2 Au 2,5-5 Ni	1,00±0,05	min. 1,60	in: 150 N per pin